

BGA Heat Sink - High Performance maxiFLOW/maxiGRIP-Low Profile



ATS Part#:

ATS-51230K-C1-R0

Description:

23.00 x 23.00 x 14.50 mm BGA Heat Sink - High Performance maxiFLOW/maxiGRIP-Low Profile

Heat Sink Type:

maxiFLOW

Heat Sink Attachment:

maxiGRIP

Equivalent Part Number:

ATS-51230K-C2-R0 Discontinued

**Image above is for illustration purpose only.*

Features & Benefits

- maxiFLOW™ design features a low profile, spread fin array that maximizes surface area for more effective convection (air) cooling
- maxiGRIP™ attachment applies steady, even pressure to the component and does not require holes in the PCB
- Meets Telcordia GR-63-Core Office Vibration; ETSI 300 019 Transportation Vibration; and MIL-STD-810 Shock and Unpackaged Drop Testing standards
- Comes preassembled with high performance, phase changing, thermal interface material
- Designed for low profile components from 1.5 to 2.99mm

Thermal Performance

AIR VELOCITY		@200 LFM 1.0 M/S	@300 LFM 1.5 M/S	@400 LFM 2.0 M/S	@500 LFM 2.5 M/S	@600 LFM 3.0 M/S	@700 LFM 3.5 M/S	@800 LFM 4.0 M/S
THERMAL RESISTANCE	Unducted Flow	6.6 °C/W	5.4 °C/W	4.7 °C/W	4.2 °C/W	3.9 °C/W	3.6 °C/W	3.4 °C/W
	Ducted Flow	5.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Product Detail

Schematic Image	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension D	TIM	Finish
<i>*Image above is for illustration purpose only.</i>	23.00 mm	23.00 mm	14.50 mm	41.5 mm	T766	BLACK- ANODIZED
Notes: - Dimension A and B refer to component size. - Dimension C is the heat sink height from the bottom of the base to the top of the fin field. - ATS-51230K-C2-R0 is the exact heat sink assembly with an equivalent thermal interface material (Saint Gobain C1100F). NOTE: Saint Gobain C1100F is discontinued effective 12/31/10. - Thermal performance data are provided for reference only. Actual performance may vary by application. - ATS reserves the right to update or change its products without notice to improve the design or performance. - ATS certifies that this heat sink assembly is RoHS-6 and REACH compliant. - Optional maxiGRIP™ Installation/Removal Tool Set P/N: MGT230 - Contact ATS to learn about custom options available.						

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9